

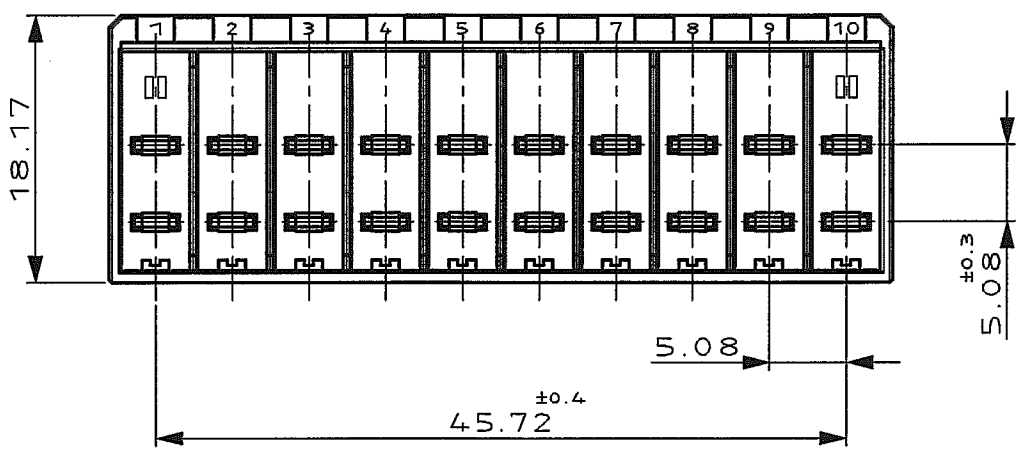
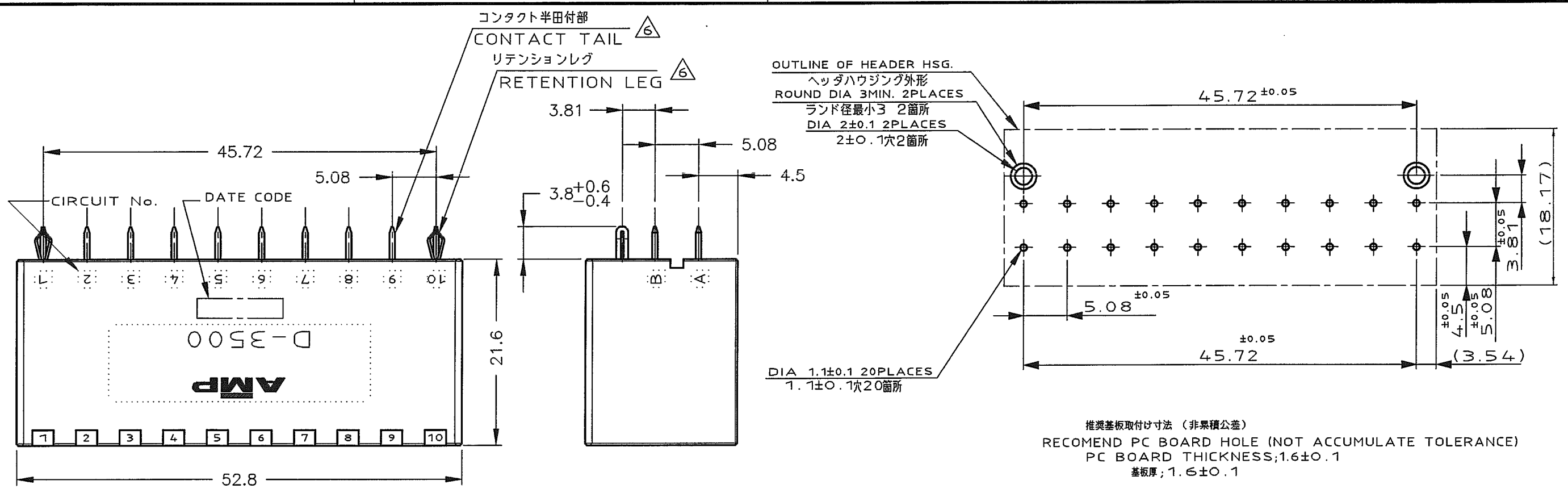
NUMBER 316517

METRIC

PROJ NO.395-623

PRINT DIST 単位: 各 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/83



OUTLINE OF HEADER HSG.
ヘッダハウジング外形
ROUND DIA 3MIN. 2PLACES
ランド径最小3 2箇所
DIA 2±0.1 2PLACES
2±0.1穴2箇所

DIA 1.1±0.1 20PLACES
1.1±0.1穴20箇所

推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
RECOMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS; 1.6±0.1
基板厚; 1.6±0.1

NOTES

- 1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, UL94V-0
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂, UL94V-0
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.38 μm MIN
- △3. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.76 μm MIN
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	-5
△6	△3	-3
△6	△2	316517-2
FINISH	型番	PART NUMBER

Copyright ©1995 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1995 Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DYNAMIC (D-3500) 20 POS. V HDR. ASS'Y		A3 J C-316517	
REVISION RECORD		REVISION RECORD	
B	REVISED (FJD0-0039-03)	TS	J.M. 10/25/93
A	REVISED (FJD0-0114-03)	TS	SM 10/25/93
O	RELEASED FJ00-3261-95	NM	Y.I. 10/24/95
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE
DR. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		DE. 24 OCT 95 N.MATSUBARA	
CHK. 24 OCT 95 Y.ISHIKAWA		APP. 24 OCT 95 S.MANABE	
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE)		仕上 (FINISH) (SEE NOTE)	
注記参照		注記参照	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		尺貫 (SCALE)	
10mm以下: ±0.35		2/1	
10mm超 3mm以下: ±0.4		REV. B	
30mm超 100mm以下: ±0.45		SHEET 1 OF 1	
角 度: ±3'			